



Helsinki – hier tagt die ESTC im September

■ **Electronic System Integration Technology (ESTC) Conference**

16.-18. September 2014, Helsinki, Finnland



Für die ESTC in Helsinki ist das Programm herausgegeben worden, aus diesem Anlass möchten wir alle Interessenten nochmals auf das Event hin-

weisen. Es konnten einige hochrangige Sprecher für Keynotes gewonnen werden:

- Lauri Oksanen, Nokia: ‚Developing Future Telecom Systems‘
- Rao Tummala, Georgia Institute of Technology: ‚Next Frontier in Electronics: Systems Scaling for Smart and Wearable Systems‘
- Charles Bauer, TechLead Corp.: ‚Nanotechnology in Electronics Packaging, Interconnect, and Assembly – Hype or Reality?‘

- Thomas Schafbauer, Infineon: ‚Technologies Package as a Product Feature‘

Am Vormittag des 16. September finden mehrere Short Professional Courses statt, bevor um 13.00 Uhr die Eröffnung geschieht. Neben den Vortragsreihen gibt es in den Pausen eine begleitende Ausstellung sowie die Präsentation der Poster.

Helsinki und die benachbarten Städte Espoo und Vantaa sind das wirtschaftliche Zentrum von Finnland und Standort zahlreicher Unternehmen der Elektronikindustrie sowie wichtiger Institute und Hochschulen.

IMAPS unterstützt die Konferenz der IEEE-CPMT und möchte Sie einladen, die Konferenz für Ihre Weiterbildung, zum Networking oder als Aussteller zu nutzen. Informationen zu den Möglichkeiten der begleitenden Ausstellung sowie einige Das komplette Programm finden Sie auf der Website <http://www.ests2014.eu>.

**Eindrücke von der IMAPS-Konferenz ‚High Temperature Electronics HiTEC 2014‘**

Elektroniktechnologien für hohe Einsatztemperaturen stellen alle Beteiligten entlang der Wertschöpfungskette vor spezielle Herausforderungen. In vielen Bereichen wie motornähe KFZ-Elektronik, Industriensensorik, Geothermie, Öl- und Gaskundung, Avionics oder Leistungselektronik muss mit Temperaturen über 150 °C – so die derzeitige Definition für Hochtemperaturelektronik – umgegangen werden. Spezialisten verschiedenster Fachgebiete, die sich diesen Anforderungen aus ihrer jeweiligen Sichtweise stellen müssen, fanden sich vom 13. bis 15. Mai 2014 in Albuquerque/New Mexico zur Konferenz High Temperature Electronics HiTEC 2014 zusammen, um sich auszutauschen, Zusammenarbeit und Projekte anzubahnen oder sich über den Stand der Technik zu informieren. Die 269 Teilnehmer und 37 Aussteller kamen aus den Bereichen hochtemperaturtauglicher Halbleiter, Schaltungsträger, Aufbau- und Verbindungstechnologien ebenso wie Anwender, Analyseexperten oder Entwickler und Hersteller passiver Komponenten und Kontaktmaterialien.



HiTEC-Auditorium

Einen wesentlichen Anteil an Erfolg und Motivation solcher Veranstaltungen haben die begleitenden Ausstellungen, wo gute Gespräche über die jeweiligen sprichwörtlich ‚heißen‘ Themen zustande kommen. Die Sessions fassten Fachvorträge aus Hauptapplikationen wie Power und Sensoren und spezifischen Herausforderungen wie Passive Bauelemente, Die Attach, Löten oder Trägermaterialien zusam-



HiTEC-Ausstellung



HiTEC-Vortrag

**Veranstaltungskalender**

Ort	Zeitraum	Name	Veranstalter
Helsinki	16.-18. Sept. 2014	ESTC 2014	IEEE CPMT
München	23.-24. Okt. 2014	Herbstkonferenz 2014	IMAPS D
Friedrichshafen	13.-16. Sept. 2015	EMPC 2015	IMAPS Europa, IMAPS D

men. Eine Session zu Applikationen rundete den Abschlussstag mit eindrucksvollen Beispielen ab.

Die Microelectronics Foundation hatte einen mit 1000 \$ dotierten Student Paper Award ausgelobt, den Fang Yu von der Auburn University für ihre Arbeit über ‚Druckloses Niedertemperatursintern von Silberpaste als Die Attach für 300°C Anwendungen‘ gewann.

Die Konferenz findet im Wechsel mit der Schwesterkonferenz HITEN in Großbritannien statt, die nächstes Jahr im Juli in Oxford von IMAPS UK ausgerichtet wird.

### ■ Die Proceedings

Jene des diesjährigen Seminars in Dresden zum Thema ‚Volumenintegration – Stapen, Falten, Vergraben‘ können auf CD zum Preis von 55,- € erworben werden.



Die Proceedings-CD 2014

Die aktuelle CD-ROM enthält neben den 2014er-Proceedings auch die mehrerer früherer Herbst- und Frühjahrsveranstaltungen. Unsere Seminare sind traditionell themenorientiert und beschäftigten sich zuvor mit zu Themen wie ‚Medizintechnik- Herausforderungen an das Packaging‘, ‚Manche mögen’s heiß – Power Electronic Packaging‘ oder ‚Ist Zuverlässigkeit noch bezahlbar?‘.

Ihre Bestellungen richten Sie bitte an:

Ernst Eggelaar, c/o Microtronic GmbH,  
Kleingrötzing, D-84494 Neumarkt-St.Veit,  
Fax +49-8722-9620-30, E-Mail: ee@microtronic.de  
Bitte beachten Sie, dass der angegebene Preis gemäß §4 Nr.22 UStG umsatzsteuerfrei ist und die verfügbare Anzahl begrenzt ist.

### ■ IMAPS Deutschland – Ihre Vereinigung für Aufbau- und Verbindungstechnik

IMAPS Deutschland, Teil der ‚International Microelectronics and Packaging Society‘ (IMAPS), stellt seit 1973 in Deutschland das Forum für alle dar, die sich mit Mikroelektronik und Aufbau- und Verbindungstechnik beschäftigen. Mit mehr als 300 Mitgliedern verfolgen wir im Wesentlichen drei wichtige Ziele:

- Wir verbinden Wissenschaft und Praxis
- Wir sorgen für den Informationsaustausch unter unseren Mitgliedern und
- Wir vertreten den Standpunkt unserer Mitglieder in internationalen Gremien

### ■ Impressum

IMAPS Deutschland e.V.

1. Vorsitzender:

Dr.-Ing. Martin Schneider-Ramelow

[martin.schneider-ramelow@izm.fraunhofer.de](mailto:martin.schneider-ramelow@izm.fraunhofer.de)

Schatzmeister

(bei Fragen zu Mitgliedschaft und Beitrag):

Ernst J. M. Eggelaar, [ee@microtronic.de](mailto:ee@microtronic.de)



Ausführliche Kontaktinformationen zu den Vorstandsmitgliedern finden Sie unter [www.imaps.de](http://www.imaps.de) (Vorstand)